

第4回 電子デバイス実装研究委員会プログラム

日時:平成25年 12月 3日(火) 10:30~16:25

場所:自動車会館 大会議室(2F) (東京都千代田区)

時間	題目	講演者
	司会 水野 潤(早稲田大学)	
10:30~ 12:00	『WLCSPの落下衝撃時における ポリイミド層の応力緩衝効果』 (45分)	芝浦工業大学 ○ 荻谷 義治、坂巻 一星、 旭化成イーテリアルズ 安西 信裕、 藤田 充
	『LSI 内蔵パッケージ基板の開発動向』 (45分)	日本電気(株) ○ 大島 大輔
12:00~ 13:00	昼食休憩	
13:00~ 13:05	委員会議事	
	司会 荻谷 義治(芝浦工業大学)	
13:05~ 14:35	『電子ビーム金属積層造形装置 (金属3Dプリンター)』 (45分)	(株)エイチ・ティー・エル ○ 赤野 恒夫
	『常温・低温接合の最新技術と その接合メカニズム』 (45分)	イーヴィグループジャパン(株) ○ 川野 連也
	休憩(20分)	
	司会 高尾 尚史((株)豊田中央研究所)	
14:55~ 16:25	『定常法による電子デバイス材料の界面を含む 熱抵抗測定とはんだ接合部の温度変化率にお ける熱疲労寿命特性について』 (45分)	エスペック(株) ○ 青木 雄一、小林 晶子
	『金属酸化物を用いたナノ粒子接合技術』 (45分)	(株)日立製作所 ○ 宝蔵寺裕之、守田俊章、保田雄亮

()内時間は、質疑応答時間を含む

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。